

无锡芯朋微电子股份有限公司

2025 年年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现营业收入为 114,000 万元左右，与上年同期相比，将增加 17,540 万元左右，同比增长 18%左右。

2、预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,500 万元左右，与上年同期相比，将增加 7,367 万元左右，同比增长 66%左右。

3、预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5,500 万元左右，与上年同期相比，将减少 1,812 万元左右，同比下降 25%左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）营业收入：96,459.57 万元。

（二）利润总额：10,183.80 万元。归属于母公司所有者的净利润：11,133.01 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,312.20 万元。

（三）每股收益 0.87 元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务的影响

公司以“半导体能源赛道”为核心战略方向，2025 年度营业收入预计增长

18%左右，主要增长源泉如下：

1、得益于新兴市场（服务器/通信/工业电机/光储充/新能源车）营收同比大幅成长 50%左右。公司在服务器与通信、新能源等新领域实现技术共享与场景互补，通信二次电源用高集成数模混合芯片系列、新能源用多款集成驱动芯片系列及 800V~1700V 超高压工业电源芯片系列等重大创新产品进入量产；2025 年，公司重磅推出 12 款面向 AI 计算能源领域的核心新品，全面完成服务器一次电源、二次电源到三次电源的全链路布局，其中面向 800V HVDC 系统的 1700V SiC 辅源、隔离驱动、SiC/GaN 驱动等芯片、兆赫兹开环 DCX 控制器、全集成数字硬开关全桥控制器、8/12/16 多相 VRM、70/90A Cu-Clip DrMOS、EFuse、PoL 等高性能功率产品可满足高算力服务器对电源转换效率、稳定性及小型化的要求。彰显公司已从家电应用市场模拟芯片供应商向工业系统级电源解决方案供应商加速演进。

2、得益于新品类产品（DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）营收同比大幅增长 39%左右。公司进一步完善自身的“电源和电机系统级整体解决方案”战略，目前已基于五大核心技术（半导体高压器件/高低压集成工艺技术/数字电源技术/高密度功率封装技术/器件级失效分析技术）构筑出六大具备协同效应的产品线（AC-DC、DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）架构，其中非 AC-DC 产品线持续推新品，其业务成长速度高于 AC-DC 产品线。彰显公司已从 AC-DC 模拟芯片供应商向系统级电源解决方案供应商加速演进。

（二）期间费用的影响

报告期内，公司研发投入规模持续加大。主要是公司加速技术平台迭代，投入多相数字技术平台、DrMOS 特殊工艺新技术平台，从第三代“智能 MOS 超高压双片高低压集成平台”升级至“第四代全新智能功率芯片技术平台”，大幅提升产品性能与集成度。同时，公司持续加大服务器重点赛道投入，针对性扩充数字设计、大电流器件设计等技术开发团队和实验投入，提升新赛道产品开发适配能力；进一步向成为系统级电源解决方案供应商努力。

（三）非经营性损益的影响

2025 年 9 月，公司通过“90%股份+10%现金”方式出售芯联集成（688469.SH）

子公司芯联越州 1.67% 股权，其中 90% 股份对价部分，一方面增加公司账面公允价值变动收益，另一方面强化公司与上游供应商芯联集成（688469.SH）的战略合作。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日